



2017年7月20日

各 位

## 高周波基板用電解銅箔の生産体制増強

～台湾工場の生産能力を1.6倍へ増強し275t/月体制へ～

当社（社長 西田計治）は、高周波基板用銅箔「VSP<sup>®</sup>」の生産能力を275t/月体制に増強することを決定しましたので、お知らせいたします。

当社の高周波基板用銅箔「VSP<sup>®</sup>」は、優れた表面平滑性と微細粗化处理により、高周波数帯におけるプリント基板の伝送損失低減に大きく寄与することから、お客様より高い評価を得ております。

VSP<sup>®</sup>は台湾工場（台湾銅箔股份有限公司）の主力製品であり、主に通信インフラ機器（サーバー、ルーター、基地局など）の高周波基板用として、お客様の需要に応じて参りましたが、データ通信の高速化・大容量化を背景として昨年来より販売量が大幅に増加しております。この旺盛な需要に対応するべく、台湾工場の現有設備の一部改造と電解設備の新設によって生産能力を現行の175t/月体制から275t/月体制へ増強し、2018年4月より順次稼働を開始いたします。

当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、安定した品質を維持し、お客様への十分な供給能力を確保してまいります。

以 上

### 【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール PR@mitsui-kinzoku.co.jp



一般銅箔



VSP®

写真 アップルマンゴーが映り込んだ銅箔の表面

※VSP®は、鏡面のような優れた表面平滑性が特徴

(ご参考)

台湾銅箔股份有限公司について

- (1) 名称 : 台湾銅箔股份有限公司
- (2) 所在地 : 中華民国南投県南投市
- (3) 董事長 : 福本 浩敏
- (4) 設立 : 1980年11月
- (5) 資本金 : 800百萬元
- (6) 出資者 : 当社95%
- (7) 事業内容 : プリント配線板用銅箔の製造